

华天科技 (002185. sz)

低成本优势，技术层次和客户结构有待改善

周瑾 家电/电子元器件 研究员

电话: 020-87555888-878

eMail: zj19@gf.com.cn

位居内资同行第三，但市场份额仍小

公司属于军转民性质（军工业务已剥离出上市公司），从事集成电路封装、测试行业。2004-2006 年间年封装能力从 10 亿块增加到 25 亿块，销售收入从 2.15 亿元增长到 5.16 亿元。2006 年产能利用率为 77.67%。

2005 年公司集成电路封装总数和销售收入位列内资企业的第三位，但相比外资大厂仍差距较大，而且只占国内市场销售额的 0.91%。

成本优势明显，技术层次和客户结构尚待提升

半导体企业的竞争力因素按照重要程度依次为：技术、成本、服务。公司重要优势是低成本的电、劳动力和优惠的税收。但是，公司过于依赖西北的地利，并非像 DELL 公司通过高效运营形成的低成本，因此竞争壁垒并不稳固。

另外，公司的技术层次、客户结构尚待提升。

风险提示

公司需要持续提升自主研发、精细管理和客户服务能力，才能确保募股产品顺利批量生产和开拓市场；产能利用率的变动值得关注。

业绩预测、投资建议

预计 2008 年每股收益 0.50 元，采用 25 倍的动态 PE，每股合理价值 12.5 元。根据中小板科技类公司的上市首日表现和当前市场情况，预计公司上市价格区间 27.5 元-30.0 元。一旦股价超过 15 元，建议“卖出”。

预测及评估

	2005A	2006A	2007E	2008E	2009E
主营收入(万元)	31,381.64	51,269.46	64,400	79,400	94,400
EBITDA(万元)	4,466.87	6,402.14	15,392	18,183	21,618
净利润(万元)	3,874.81	6,161.93	7,493	8,684	10,325
净利润增长率	61.13%	59.03%	20.77	15.90	18.90%
每股收益(元)	0.35	0.52	0.431	0.500	0.593
市盈率	0.00	0.00	24.48	21.10	17.79
市净率	0.00	0.00	2.07	1.85	1.76
EV/EBITDA	0.00	0.00	11.93	10.10	8.49
每股红利(元)	0.00	0.00	0.15	0.2	0.25
股息率	0.00	0.00	1.42%	1.90%	2.37%

来源：天水华天科技股份有限公司财务报表，广发证券发展研究中心

注：2007 年以后每股收益、市盈率、市净率均采用发行后股本计算

价格区间

发行价格	10.55 元
上市价格	28.75 元

股票数据

总股本(万股)	13,000.00
流通 A 股(万股)	4,400.00
主要股东:	
天水华天微电子股份有限公司	
主要股东持股比例	37.36%
流通 A 股比例	25.29%

财务比率

ROE	22.06%
ROA	9.71%
资产负债率	55.98%
每股净资产(元)	2.15

2006 年报数据

发行信息:

发行价格(元)	10.55
主承销商:	
国信证券有限责任公司	
发行市盈率	29.97

目录索引

公司简介	4
股权关系	4
营业模式：加工收费型	4
业绩快速增长，优势是要素价格低	5
竞争优势劣势	6
成本上具有相当优势	6
技术水平有待提升	8
客户结构需要优化	10
企业面临的机会和挑战	11
业绩预测、投资评级和风险提示	11
募投项目属于中高端层次，但批量生产和市场开拓需要时间	11
业绩预测和投资评级	12
风险提示	13
附录：全球半导体及封装环节的市场格局	13

图表索引

表 1：公司发行前的股东结构	4
表 2：2004 年-2007 年 1-6 月公司的收入、利润	6
表 3：2004-2007 年上半年各产品主要原材料和能源所占成本比例	6
表 4：2004-2007 年上半年公司的电、煤价格	7
表 5：2006 年可比企业的人均工资福利	7
表 5：2004-2007 年上半年可对比公司的所得税率	7
表 6：2006 年可比企业的人均产值和人均创利	7
表 6：各公司机器和设备的折旧速度	8
表 7：2007 年上半年公司各系列产品的销售情况	8
表 8：2000-2005 年封装技术的市场比例变动情况	8
表 9：各种封装形式的应用领域	9
表 10：各公司研发投入/主营业务收入的比重	9
表 10：研发团队资历和成果	9
表 11：2006 年可对比企业业务的地区结构	10
表 12：2006 年主要下游客户的收入、盈利情况	10
表 13：生产管理和质量管理的认证情况	10
表 14：国内封装测试企业类别	11
表 15：新募投项目的资金投资和产能实现进度	11
表 16：计划投资项目的产品用途、产能规划和所处阶段	12
表 17：利润表预测	12
表 18：近期中小板科技类公司上市首日收盘价对应的市盈率	13
表 19：2005 年全球十大封装企业及市场份额	13
表 20：中国主要封装测试厂家集成电路封装形式及 2005 年封装量 ..	14

表 21: 在中国主要封装测试厂家集成电路封装形式及 2005 年封装量	14
图 1: 半导体产业链示意图	4
图 2: 半导体封装的流程	5
图 3: 集成电路封装技术发展阶段	9

公司简介

股权关系

天水华天科技股份有限公司地处甘肃天水，属于是军转民性质（军工业务已被剥离出上市公司）。2003 年公司的前身以其集成电路封装、测试业务的净资产出资，同时公司高管、下游客户等以现金出资，共同发起设立。

公司发行前总股本 13,000 万股，本次计划募集资金 4.64 亿元，发行数量为 4,400 万股。发行价格为 10.55 元/股，对应市盈率 29.97 倍(按照 2006 年经扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

表 1: 公司发行前的股东结构（单位：%）

发行前股东名称	持股比例
微电子股份	50.00
盛宇投资	11.46
士兰微	7.69
友旺电子	7.69
盈富泰克	11.54
遐略投资	5.08
杨国忠	3.85
无锡源生	0.77
葛志刚	1.15
上海贝岭	0.77

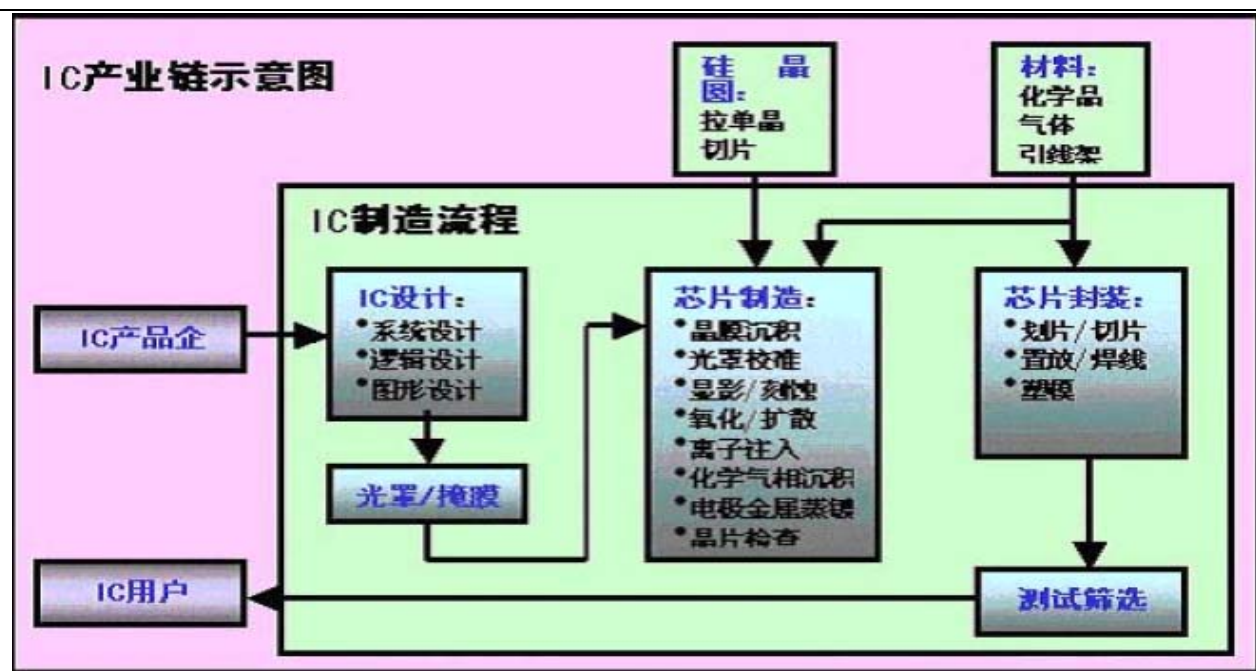
数据来源：招股说明书

值得注意的，公司引入下游客户士兰微、上海贝岭等作为股东，以稳定订单和增强合作；我们认为，基于担心商业秘密泄漏或服务质量差异，其它下游企业（特别是参股股东的竞争对手）与华天科技的合作意愿、深度可能会受到影响。

营业模式：加工收费型

集成电路产业链分为电路设计、芯片制造、封装及测试三个环节。近年来三个环节出现垂直分工的趋势，并已经发展成为独立的子行业。

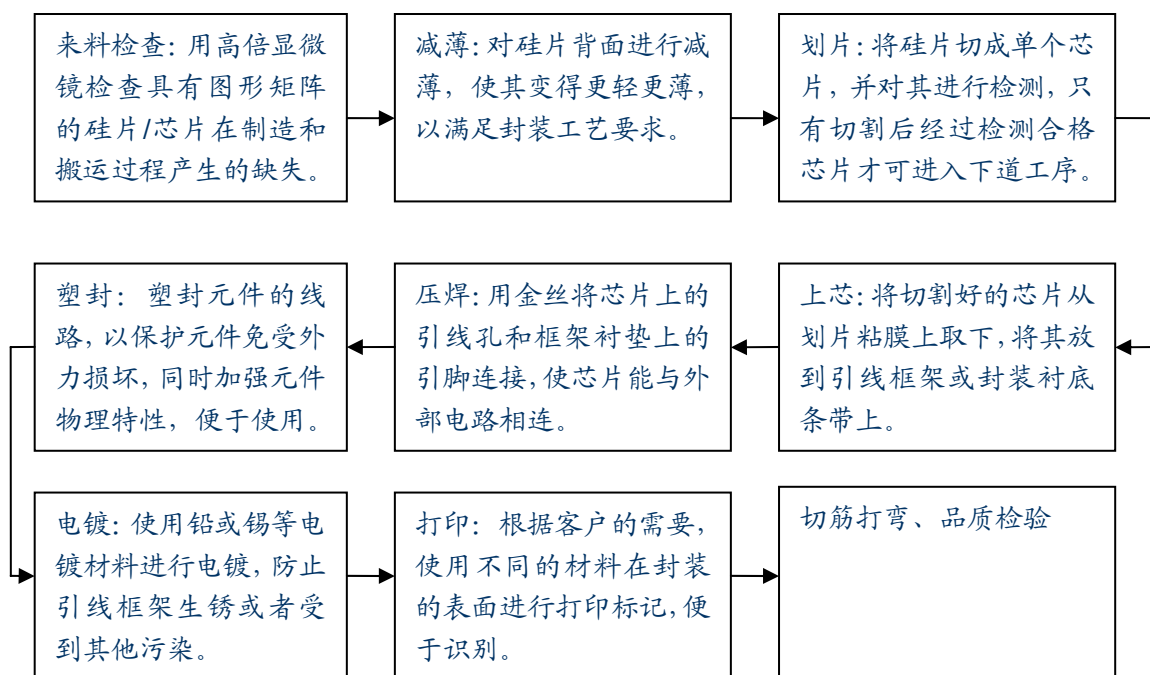
图 1: 半导体产业链示意图



数据来源：南通富士通招股说明书

集成电路塑料封装、测试企业的经营模式为来料加工：客户提供晶圆，企业按照要求对其进行塑料封装、测试后将成品交还客户，仅收取加工费。生产流程如下：

图 2：半导体封装的流程



数据来源：招股说明书

业绩快速增长，优势是要素价格低

2004-2006年，公司营业收入、净利润年复合增长54.78%、60.86%。三年又一期毛利率、净利率为20.66%、11.76%。

表 2：2004年-2007年1-6月公司的收入、利润（单位：万元）

	2007 年1-6 月	2006 年	2005 年	2004 年
营业收入	30,666.68	51,560.86	31,517.02	21,521.90
营业成本	23,798.41	41,562.08	25,280.40	16,986.45
营业利润	3,978.27	5,634.74	2,781.41	2,096.68
利润总额	4,168.06	5,675.91	3,781.03	2,399.11
净利润	3,579.82	6,204.32	3,845.29	2,397.73
固定资产	35,866.51	32,566.52	23,773.51	17,711.72

数据来源：招股说明书

半导体封装企业竞争力的决定因素按重要程度依次为：1、技术开发能力；2、效率和成本；3、客户服务能力。我们认为，华天科技主要的竞争优势是成本，而技术层次和客户结构尚存不足。

然而，公司过于依赖地处西北的地利，而并非类似DELL公司通过高效率来降低成本，存在被仿效的风险。目前，Intel、中芯国际已在中国西南地区开设半导体的制造、封装厂。因此，华天需要增强技术和服务的能力，才能形成难以仿效的竞争力。

竞争优劣势

成本上具有相当优势

广义上，企业成本可包括：1、原料、劳动力、运输成本、折旧成本、税收；2、效率，比如材料利用率和劳动生产率；3、产品合格率。

表 3：2004-2007年上半年各产品主要原材料和能源所占成本比例

项目	2006 年度
金丝	24.82%
框架	25.03%
塑粉	13.19%
燃料动力	2.89%
其他	34.06%
合计	100.00%

数据来源：招股说明书

金丝、框架、塑粉上，均从充分竞争的市场上采购，价格与竞争对手相距应该不大；产品合格率上，公司和竞争对手南通富士通的都是99.7%；企业运营效率上，数据未有披露。因此，公司优势可确证的是区域特性的电、燃料、劳动力价格和税收优惠。虽然存在运输费用高、人均产值低的问题，但公司总体上仍然具有成本优势。

另外，公司相较国外企业的折旧速度较慢，短期有利于减少企业成本，长期却不利于更新技术层次和提高企业竞争力。

一、成本的优势

用电及动力运行费用：燃料、电费价格较低，我们认为主要原因是天水市的煤炭产量较大。根据天水市政府网站公布，2007年1-9月份全市煤炭产量1,429.7万吨。2006年，公司实际电价为0.45 元/度，与东部、南

部地区0.70 元/度以上的电价相比，约便宜35%。

表 4：2004-2007年上半年公司的电、煤价格

能源	2007 年1-6 月	2006 年度	2005 年度	2004 年度
电（元/度）	0.48	0.45	0.44	0.40
煤（元/吨）	290	286	282	219

数据来源：招股说明书

劳动力成本：2006年公司职工工资及相关支出占据营业收入的8.91%，而人均工资福利只是约为国内竞争对手的35%-60%。

表 5：2006 年可比企业的人均工资福利（单位：万元）

	华天科技	长电科技*	南通富士通**
人均工资福利	1.87	5.48	3.15

数据来源：各公司年报、广发证券发展研究中心

注：*长电科技位处江苏江阴

**南通富士通位处江苏

税收优惠和补助：公司享受国家关于实施西部大开发的相关优惠政策和所得税减免。2005-2006年公司的所得税率为负，这意味着不但免除税收，还获得相关补助。假设华天科技及其控股子公司不享受上述所有税收优惠政策，同时所得税按照33%税率征收，则对公司2004-2007 年上半年净利润的累计影响额分别为985.18 万元、1,971.51 万元、2,467.03 万元、750.13 万元。

表 5：2004-2007年上半年可对比公司的所得税率

	2006 年	2005 年
华天科技	-9.31%	-1.70%
长电科技	31.44%	32.67%
南通富士通	12.34%	13.16%

数据来源：各公司年报、招股说明书

二、成本的不足之处

人均产值和创利：公司在生产过程中更多地应用人力，人均产值只有竞争对手的35%-53%，人均创利则为43%-53%。可以发现，公司劳动力的人均产值和创利水平与其成本廉价程度相匹配，这意味着公司尚未充分提升劳动力价值。

表 6：2006 年可比企业的人均产值和人均创利（单位：万元）

	华天科技	长电科技*	南通富士通**
人均产值	21.00	59.98	39.12
人均创利	1.46	2.77	3.40

数据来源：各公司年报、招股说明书

运输费用上：由于地处偏僻，2006年公司运输费用782.28万元，占营业收入的1.53%。相比之下，竞争对手南通富士通的运输费用只有264.13 万元，占营业收入的0.26%。

折旧成本：封装测试业属于重资产。业内强者采取快速折旧，加快产品线更新换代速度，最终形成更强的竞争力。但是，国内公司普遍采取较长折旧期。

如果采用与国际相仿的折旧速度,预计国内企业的销售净利率将普遍降低3-4个百分点。

表 6: 各公司机器和设备的折旧速度

企业	设备折旧速度
日月光测试	2-6 年
Amkor	3-7 年
矽品*	测算约为 4 年
华天科技	8-10 年
南通富士通	8 年
长电科技	8-12 年

数据来源: 各公司年报、广发证券发展研究中心

注: *矽品折旧速度是根据2006年折旧额除以固定资产

技术水平有待提升

集成电路技术的发展并不意味着一代新技术淘汰一代旧技术,实际上是多代并存,以成本最低、收益/投入比最大的原则各自占领相关应用领域。但是,技术水平较低的层次由于竞争壁垒较低而常常利润率较低。

企业研发水平的高低可体现在所用技术诞生年代、应用领域、公司研发投入、研发队伍资历和成果。

技术产生年代: DIP、SOP、QFP诞生于七、八十年代, SSOP诞生于九十年代。根据图2, DIP、SOP、QFP的市场份额处于萎缩中。然而,公司超过80%的产品集中这三类产品上,在更高端领域BGA、CSP等尚未建树。

表 7: 2007年上半年公司各系列产品的销售情况

产品	销售收入 万元	收入比例 %	平均销售价格 元/块	毛利率 %
DIP 系列	10,499.23	34.57	0.211	14.07
SOP 系列	9,872.91	32.51	0.199	21.65
SSOP 系列	2,173.97	7.16	0.432	41.20
QFP 系列	4,341.80	14.30	1.169	32.72
SOT 系列	2,823.75	9.30	0.155	19.01
其他	658.25	2.17	0.470	22.23
综合	30,666.68	100	0.240	21.78

数据来源: 招股说明书

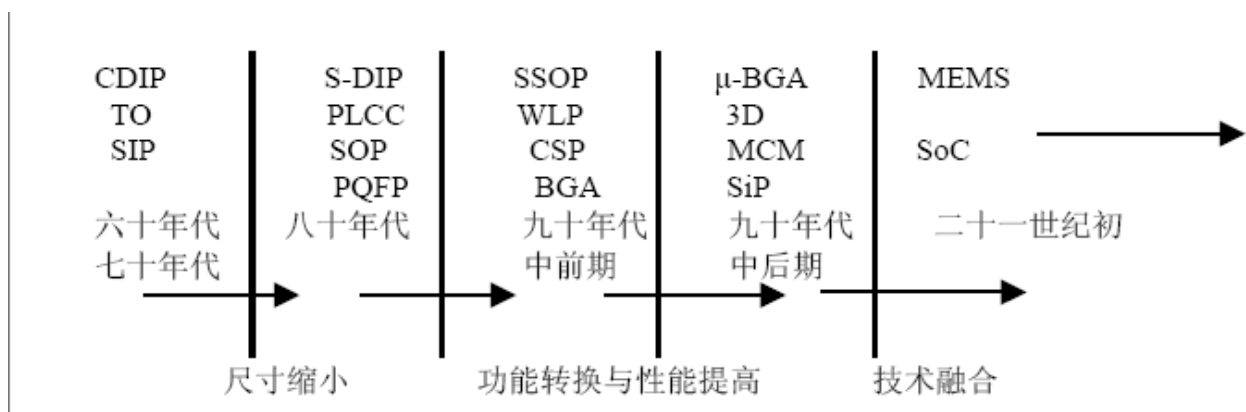
表 8: 2000-2005年封装技术的市场比例变动情况

产品类别	2000年		2005年		2005年相对于 2000年增长率%
	产值 亿美元	市场比例 %	产值 亿美元	市场比例 %	
DIP	7.34	3.5	4.76	1.4	-35.1
SOP	48.42	23.2	57.83	17.6	+19.4
PLCC	5.91	2.8	5.26	1.6	-11.0
QFP	47.42	22.7	61.71	18.7	+30.1

PGA	30.37	14.5	38.91	11.8	+28.1
BGA	55.93	26.8	113.42	34.4	+102.8
CSP	13.49	6.5	47.39	14.4	+255.3
合计	208.88	100	329.28	100	

数据来源: CCID

图 3: 集成电路封装技术发展阶段



数据来源: 华经经济信息中心、南通富士通招股说明书

应用领域: 公司产品集中在音响、电话机、电视机、MP3电路, 尚未大规模进入计算机、通讯等领域。

表 9: 各种封装形式的应用领域

序号	封装形式	应用领域
1	DIP	音响电路、电话机电路、电视机电路和音频功率放大电路
2	SOP	音响电路、DVD 电路、电话机电路、电源管理、音频处理器和遥控玩具
3	SSOP	电源管理、遥控电路和电表电路
4	QFP	LED/VFD 驱动电路、存储器、MP3 相关多媒体产品
5	SOT	电源管理、光电耦合和电子开关

数据来源: 华天科技招股说明书

研发投入: 研发投入是企业吸引研发人才和开发新型技术的根本保障。公司的研发投入比例处于中等水平, 但只有日月光测试和南通富士通的50%和33%。

表 10: 各公司研发投入/主营业务收入的比例

企业	研发投入比例
日月光测试	4.0%
Amkor	1.4%
矽品	2.1%
华天科技	2.3%
南通富士通	5.9%

数据来源: 各公司年报、招股说明书

研发团队和成果:

表 10: 研发团队资历和成果

华天科技	南通富士通
------	-------

研发团队	研发人员51人，本科以上学历占30%，大专以上学历占80%，均有5年以上从事本专业研发的经验。	研发人员40人，全部为大专以上学历，都有8年以上从事本专业研发的经验，均先后赴国外接受过专业培训。
无铅化封装	使用铅或锡等电镀材料进行电镀，2007年6月末获得无铅电镀产业化发展基金150.00万元。	无铅化封装率达90%以上
大尺寸封装	在原有减薄技术上将最大为12英寸晶圆厚度减至 $150 \pm 10\mu\text{m}$ ，晶圆平整度达到 $10\mu\text{m}$ 以下。	2005年底公司首批12英寸芯片封装生产线设备进厂试产成功，在国内首先具有了12英寸芯片封装的产业化配套能力。

数据来源：各公司招股说明书

客户结构需要优化

出口认证：公司尚未通过的一系列出口认证，如QS9000体系认证、美国UL认证、欧盟的安全标准认证，业务基本都在国内。

表 11：2006 年可对比企业业务的地区结构

	国内业务	国外业务
华天科技	94.41%	5.59%
南通富士通	20.30%	69.70%

数据来源：各公司招股说明书

主要客户的规模和盈利能力：对于封装企业来说，客户的竞争力就是公司的竞争力，客户的成功就是公司的成功。从前五大客户中的上市公司看，主要客户的收入规模、盈利情况并不理想。

表 12：2006 年主要下游客户的收入、盈利情况

下游客户	营业收入	净资产收益率
士兰微	8.74 亿	3.62%
上海贝岭	6.72 亿	1.80%

数据来源：招股说明书

生产管理：认证在相当程度上反映出企业的管理水平，这也是客户挑选供应商的重要标准。相比竞争对手，公司认证的时间和数量上均处起步阶段。

表 13：生产管理和质量管理的认证情况

华天科技	南通富士通
通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，TS16949质量管理体系正在建立之中。	1995年公司在同行业中率先通过了BVQI（法国国际质量认证有限公司）的ISO9002：1994质量体系认证；2001年分别通过了ISO14001：1996环境管理体系和QS9000质量体系认证；2002年通过了ISO 9001：2000质量体系认证。2005年通过了ISO/TS 16949：2002质量管理体系认证，认证范围为：CP、SOT系列IC封装和测试。目前公司正在执行的是ISO 9001：2000版和ISO/TS 16949：2002二项国际质量体系标准。

数据来源：各公司招股说明书

企业面临的机会和挑战

按照规模和实力划分，现阶段国内具有规模的封装测试厂家可以分为四大类。各类型的封装测试厂家在技术水平、生产规模、市场开发等方面都存在竞争差异。

表 14：国内封装测试企业类别

类型	主要特征	代表厂家
国际大型整合组件制造商的封装测试厂	为跨国半导体公司的封装测试厂，业务模式主要是承接母公司的 IC 产品后道封装测试加工，以 BGA、CSP 等为主要封装形式。	飞思卡尔（中国）有限公司（Motorola 独资）、英特尔（上海）有限公司
国际大型整合组件制造商控股的合资封装测试厂	以 SOP、QFP、PLCC 为主要封装形式。业务模式兼有 IDM 和专业封装代工。	深圳赛意法电子公司；英飞凌科技（苏州）有限公司；上海松下半导体有限公司
台资封装测试厂	台湾对半导体企业投资大陆的规模和技术有法规限制，相较于台湾省内同行业的规模和技术还有一段差距。	日月光公司（上海）有限公司；矽品科技（苏州）有限公司；京元电（苏州）有限公司
内地本土封装测试厂	国内本土封装厂技术与国际大厂的技术还有一段差距。主要业务模式为专业封装代工。	南通富士通微电子股份有限公司；江苏长电科技股份有限公司；华润华晶微电子有限公司；天水华天电子科技有限公司

数据来源：南通富士通招股说明书

内资企业从事半导体封装既有机会，也有挑战。

机会包括国内市场增速显著高于全球；封装业相对设计、制造环节的技术要求较低；中国要素成本较低。

挑战包括技术更新速度快；资金需求大；人才缺乏；先进设备进口受到国外封锁；精益生产和客户服务。

在极其强调技术、服务、资金、人才的行业中，华天科技的低成本优势并不稳固。因此，公司在上市后，将需要进一步吸引人才、提升研发，做好生产管理和客户服务，才能构建长期的综合竞争力。

业绩预测、投资评级和风险提示

募投项目属于中高端层次，批量生产和市场开拓需要时间

公司计划募集资金 4.64 亿元。预计固定资产投资 54,451 万元，铺底流动资金 5,399 万元，项目建设期 3 年。设备多数为进口，进口的设备额/总设备额超过 90%。

项目达产后，新增产量合计为 64,000 万块，均价为 1.08 元，远远高于目前公司产品均价 0.24 元。

表 15：新募投项目的资金投资和产能实现进度（单位：万元）

项目名称	总投资	2007 年 投资	2008 年 投资	2009 年 投资	以后 -
------	-----	--------------	--------------	--------------	---------

集成电路高端封装产业化项目	59,850	10,000	40,000	9,850	-
新项目产能的实现进度		-	30%	60%	100%

数据来源：招股说明书

但是，其中的4个募投项目仍处于少量试生产阶段，因此能否顺利批量生产并拓展市场尚存风险。

表 16：计划投资项目的产品用途、产能规划和所处阶段

序 号	封装类型	主要产品用途	新增产量 (万块/年)	所处阶段
1	LQFP	各类存储器、电脑用晶片组、模拟电路、通信及逻辑电路	8,000	量产
2	QFN	手机、数字相机、数字摄像机、掌上电脑、笔记本电脑等电路	25,000	少量试生产
3	BGA	各类存储器，电脑用晶片组、数字相机、数字摄像机、掌上电脑、笔记本电脑等电路	4,000	少量试生产
4	MCM	汽车电子、工业控制、计算机、消费类电子等	2,000	少量试生产
5	TSSOP	消费类电子、工业控制、通讯、计算机等	25,000	少量试生产
合 计			64,000	

数据来源：招股说明书

业绩预测和投资评级

随着项目投产，公司收入将继续增长；
行业景气度下行，毛利率将有所下降。

表 17：利润表预测（单位：万元）

	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年
一、营业总收入	51,560.86	64,400.03	79,400.03	94,400.03
减：营业成本	41,562.08	49,976.66	62,116.95	73,851.89
营业税金及附加	299.75	279.15	346.96	412.51
销售费用	1,072.95	923.85	1,148.27	1,365.20
管理费用	2,068.08	3,358.78	4,174.69	4,963.36
财务费用	802.45	976.88	1,214.18	1,443.56
资产减值损失	120.82	530.29	659.11	783.63
二、营业利润	5,634.74	8,354.37	9,739.85	11,579.88
加：营业外收入	44.17	433.25	534.16	635.08
减：营业外支出	2.99	34.71	42.80	50.88
三、利润总额	5,675.91	8,752.93	10,231.22	12,164.07
减：所得税费用	-528.40	1,235.30	1,523.03	1,810.76
四、净利润	6,204.32	7,517.62	8,708.19	10,353.31
归属于母公司股东的净利润	6,151.99	7,493.01	8,684.45	10,325.09
少数股东损益	40.95	19.26	23.74	28.23
每股收益（元）	0.366	0.431	0.500	0.593

数据来源：招股说明书、广发证券发展研究中心

注：每股收益、市盈率、市净率等按照发行后股本 1.74 亿股计算

根据下表，预计2007-2009年每股收益为0.43、0.50、0.59元，采取

市盈率25倍，未来一年每股合理价值12.5元。

近期中小板科技类公司首日上市的动态市盈率为69.22倍。鉴于华天科技竞争力有待强化以及可比公司股价普遍回落，预计公司上市首日价格对应的市盈率偏低。如果采用55-60倍市盈率，则每股价格区间为27.5元-30.0元。一旦股价超过15元，建议“卖出”。

表 18：近期中小板科技类公司上市首日收盘价对应的市盈率

公司	首日收盘价（元）	动态市盈率*
顺络电子	34.00	52.88
通富微电	31.40	84.16
御银科技	64.88	72.96
中航光电	45.56	65.06
蓉胜超微	25.35	71.05
整体	-	69.22

数据来源：各公司年报、广发证券发展研究中心

注：*市盈率是根据首日收盘价/2008年每股收益，其中2008年每股收益为Wind系统综合各券商估值的均数

风险提示

募股项目的中高端产品能否顺利批量生产和开拓市场，将对公司的创新能力（包括策略、销售、技术、制造和服务等各方面）和执行力提出考验；一旦欧、美经济下行，将对半导体行业的景气度形成压力；2006年产能利用率为77.67%，产能利用率的变动值得关注。

附录：全球半导体及封装环节的市场格局

（1）全球半导体行业格局

从整个半导体行业来看，美、日、欧等发达国家和地区仍然占据了绝对的优势地位，2005 年度上述国家和地区的厂商占据了全球半导体销售市场85%的份额，其中美国为45%，日本为27%，欧洲为13%。在2005 年全球排名前二十大的半导体生产厂商中，美国拥有7 家，日本5 家，欧洲3 家，另外韩国和中国台湾分别拥有2 家。

（2）全球集成电路封装行业的主要企业和市场份额

集成电路封装产业而言已逐步从欧美发达国家向亚太地区转移，2005 年亚洲各国占集成电路封装产业市场的70%左右，目前主要从事半导体封装的国家和地区是中国台湾、马来西亚、中国大陆、菲律宾、韩国和新加坡。

2005 年前十大企业占有全球集成电路封装市场份额的27.7%。

表 19：2005 年全球十大封装企业及市场份额

排名	公司名称	总部位置	2005 年销售收入 百万美元	市场份额 %
1	日月光集团	台湾	2,582	7.84
2	Amkor	美国	2,100	6.38

3	矽品	台湾	1,338	4.06
4	STATS - ChipPAC	新加坡	1,157	3.51
5	南茂	台湾	482	1.46
6	力成	台湾	347	1.05
7	UTAC	新加坡	325	0.99
8	京元	台湾	318	0.97
9	CARSEM	马来西亚	264	0.80
10	超丰	台湾	216	0.66
合计			9,129	27.72

数据来源：招股说明书

(3) 国内集成电路封装行业的企业

根据CCID（赛迪顾问股份有限公司）的统计，2005 年国内从事集成电路封装的企业中年封装能力超过10 亿块的有五家，公司的年封装能力和封装量在国内内资企业居于第三位。

表 20：中国主要封装测试厂家集成电路封装形式及2005 年封装量

序号	企业名称	封装量（亿块）	主要封装形式
1	江苏长电科技股份有限公司	33.31	DIP QFP PLCC SOP
2	南通富士通微电子股份有限公司	26.64	DIP QFP PLCC SOP BGA
3	深圳赛意法微电子有限公司	18.79	DIP SOP/SSOP BGA/PGA
4	天水华天科技股份有限公司	14.13	DIP QFP SOP/SSOP
5	星科金朋（上海）有限公司	12.69	PDIP/PLCC/SOIC/SSOP /QFP/BGA/CSP
6	上海纪元微科电子有限公司	7.64	DIP PLCC SOIC SSOP
7	美商国家半导体（苏州）有限公司	3.89	QFP PLCC BGA/PGA
8	瑞萨半导体（北京）有限公司	2.34	QFP SOP BGA/PGA
9	上海松下半导体有限公司	1.46	LQFP
10	上海华旭微电子公司	0.22	DIP QFP PLCC SOP

数据来源：赛迪顾问，2006.02

如果统计范围包括外资在华投资企业，华天科技则未能进入前十。

表 21：在中国主要封装测试厂家集成电路封装形式及2005 年封装量

排序	企业名称	2005 年销售额（亿元）	所在区域
1	飞思卡尔半导体（中国）有限公司	64.62	环渤海
2	威讯联合半导体（北京）有限公司	29.27	环渤海
3	深圳赛意法微电子有限公司	21.74	珠三角
4	英特尔产品（上海）有限公司	18.21	长三角
5	南通富士通微电子股份有限公司	16.62	长三角
6	英飞凌科技（苏州）有限公司	15.95	长三角
7	瑞萨半导体（北京）有限公司	13.92	环渤海
8	瑞萨半导体（苏州）有限公司	11.31	长三角
9	江苏长电科技股份有限公司	10.79	长三角
10	三星电子（苏州）半导体有限公司	9.83	长三角

数据来源：招股说明书

广发证券—公司投资评级说明

买入 (Buy)	预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10 % 以上。
持有 (Hold)	预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10% ~ +10%。
卖出 (Sell)	预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10 % 以上。

相关研究报告

广州		上海
地址	广州天河北路 183 号大都会广场 36 楼	上海浦东南路 528 号证券大厦北塔 17 楼
邮政编码	510075	200120
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn	
服务热线	020-87555888-390	

免责声明

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。

本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可，不得更改或以任何方式传送、复印或印刷本报告。